

应用介绍**特点**

一款双组份环氧树脂胶，常温或低温可固化，具有高粘接强度，低膨胀,等特点，适用于电子器件结构性粘接及灌封；具有较高的可靠性及阻燃耐候性

粘接材料

金属，塑料/PCB，玻璃，陶瓷等

典型应用

电子元器件灌封粘接

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	A: 白色; B:琥珀	
粘度(cps)	A:40000; B:195	2rpm@25°C, ASTM D-1084
混合后	6500	20rpm@25°C, ASTM D-1084
混合比例 (质量比)	14.2:1	
固化条件*	4hrs/100°C 或 8hrs/80°C 或 16hrs/60°C	
有效期@ 25°C,月	12	
TI	2	

*固化温度是指胶水表面实际达到的温度

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	灰色	
邵氏硬度	85D	ASTM D-2240
玻璃化温度	80°C	DSC,TAQ20, 40°C/Min
导热率	1.2w/m.k	
阻燃	UL94 V0	

储存和使用方法

请将产品常温25°C下储存，建议储存在干燥通风处，可以用2:1手动胶枪点胶，也可自动化点胶；点胶前请废弃掉开始混合部分少量胶水等混合均匀后再使用；使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考SDS文件；

注:

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

www.stick1mat.com

Email: info@stick1mat.com

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

